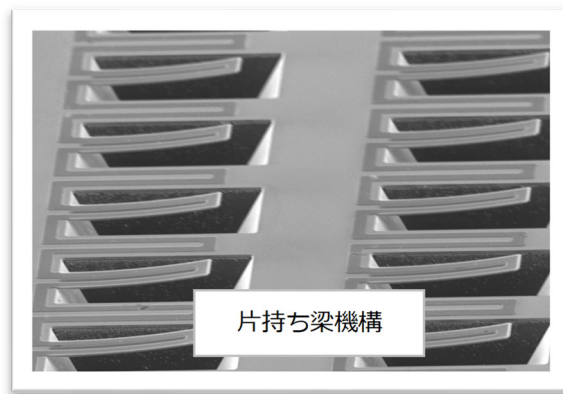
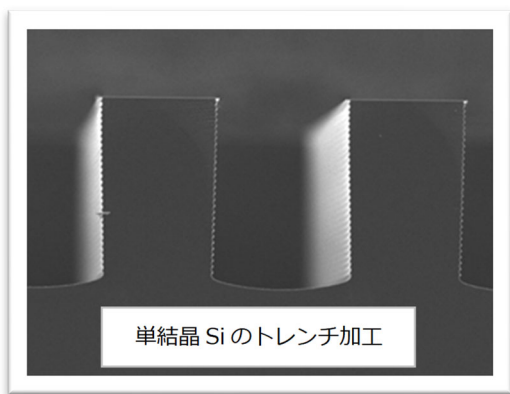




ナノ・マイクロスケールの微細加工入門シリーズ

実験動画で学ぶエッチング工程

～ウェットエッチング・ドライエッチング～



日時

2024年8月28日(水)

～ 2024年9月3日(火)

(上記視聴期間内であれば、何回でも視聴可能です。)

申込締切日

2024年

8月14日

(水)

定員

20名

受講料

1,000円

特徴

- ・実際の動画で装置や実験の様子を視聴可能
- ・微細加工、微細構造形成に関心のある方向け
- ・エッチング技術をこれから学びたい方にも最適

詳細は裏面またはこちら



お問合せ先

地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術振興室 技術セミナー係
〒135-0064 東京都江東区青海 2-4-10 TEL:03-5530-2308
メール宛先：kenshu@iri-tokyo.jp



地方独立行政法人

東京都立産業技術研究センター

TOKYO METROPOLITAN INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE

技術セミナー（オンデマンド配信）

実験動画で学ぶエッチング工程 ～ウェットエッチング・ドライエッチング～

概要

半導体・MEMS センサや、光学素子、マイクロ流路等にみられるナノ～マイクロメートルスケールの3次元デバイスの製造工程では、半導体加工技術を応用したシリコンウェハ等の微細加工が行われております。本オンデマンド配信では、反応性イオンエッチング（RIE）やシリコン深堀エッチング等のドライエッチング技術、特殊な微細形状を安価に得られる単結晶シリコン結晶軸異方性ウェットエッチング技術について実験室レベルの工程を紹介します。また、片持ち梁アクチュエータ加工事例を紹介し、加工の流れについても理解を深めていただきます。これから微細加工やエッチング技術の知識を深めたいと考えている方のご参加をお待ちしております。

※1 本配信の内容は、過去（2021～2023年度）に配信された「MEMS 微細加工入門II・エッチング」、及び「ナノ・マイクロスケールの微細加工入門シリーズ・実験動画で学ぶエッチング工程」と同等のものです。

※2 本配信の解説は音声読み上げソフトを使用しています。

※3 配信動画の著作権は都産技研に帰属します。録音・録画はご遠慮ください。

講座内容

配信時間	タイトル	講師
約60分	1. 半導体工程によるナノ・マイクロスケールの微細加工 2. エッチングの概要 3. ウェットエッチング 4. ドライエッチング 5. 加工事例の紹介	東京都立産業技術研究センター 電気技術グループ 宮下 惟人

募集要項

- 利用約款** 下記ウェブページでご確認ください。
<https://www.iri-tokyo.jp/soshiki/52/yakkan.html>
- 応募資格** 原則として、日本の法人の従業員、個人事業主または創業を予定している個人
- 申込締切** 2024年8月14日(水) ※定員を超えた場合は期日前に締め切ることがあります。
- 申込方法** 下記ウェブページの申込フォームから、お申込みください。
<https://www.iri-tokyo.jp/seminar/240828-1.html>
- 受講可否** 受講予定者には、請求書およびコンビニ払込書を郵送いたします。
定員などの関係で受講をお断りする場合、電話または電子メールでご連絡いたします。

参加方法

- 動画を視聴するには、オンデマンド配信サイトへのアカウント登録が必要です。お申込み後、自動返信メールに記載されているURLからご登録ください。過去にアカウント登録済みの方は、改めての登録は不要です。配信期間になりましたら、サイト上に動画が表示されます。
- 視聴環境(パソコンなど)は、受講者をご準備ください。
- ブラウザは、Microsoft® Edge^{※1}またはGoogle chrome^{TM※2}をご使用ください。
^{※1※2}Microsoft® Edgeはマイクロソフト社の登録商標で、Google chromeTMはグーグル社の商標です。